

# CLEARFIL™ S<sup>3</sup> BOND PLUS

## ADHÄSIVE

Bitte lesen Sie sich vor der Anwendung dieser Produkte die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch.

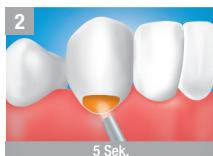
### Direkte Restauration mit lichthärtendem Komposit

Folgen Sie den Standardverfahren für Feuchtigkeitsregulierung, Kavitätenpräparation und Pulpaschutz.

BOND auf die Adhäsivfläche auftragen.



Mit sanftem Luftstrom trocknen.<sup>1</sup>



Lichthärteln. <sup>2</sup>



Komposit auftragen, lichthärteln und fertigstellen.



<sup>1</sup> Die gesamte Kavitätenwand ausreichend trocknen, bis sich das BOND nicht mehr bewegt.  
Verwenden Sie einen Absauger, um ein Verlaufen des BOND zu verhindern.

<sup>2</sup> siehe auch die Bedienungsanleitung des Lichtpolymerisationsgerätes.

## Stumpfaufbau und Stiftzementierungen mit CLEARFIL™ DC CORE PLUS

Folgen Sie den Standardverfahren für Feuchtigkeitskontrolle und Wurzelkanalvorbereitung und probieren Sie den Stift ein.

Behandlung der Stiftoberfläche.



\* Falls erforderlich, vor der Anwendung mit Aluminiumoxid-Pulver sandstrahlen.

Lichthärteln.



\* Siehe auch Bedienungsanleitung des Polymerisationsgerätes.

PASTE einbringen.



BOND auf die gesamte Adhäsivoberfläche auftragen.



Mit sanftem Luftstrom trocknen.\*



Überschüssiges BOND mit einer Papierspitze entfernen und erneut mit sanftem Luftstrom trocknen.



\* Die gesamte Adhäsivoberfläche ausreichend trocknen, bis das BOND sich nicht mehr bewegt. Verwenden Sie einen Absauger, um ein Verlaufen des BONDs zu verhindern.

Stift einsetzen und PASTE gemäß Gebrauchsanweisung härten.



PASTE um den Stift herum auftragen.



PASTE sowohl von lingual als auch labial (bukkal) gemäß Gebrauchsanweisung lichthärteln.\*



\* Nach der Lichthärtung mehr als 6 Minuten warten, wenn die Dicke der PASTE größer ist als die angegebene Polymerisationstiefe.